

龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于重新向香港联交所递交 H 股发行上市申请
并刊发申请资料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

根据本次发行上市的时间安排，公司已于 2026 年 6 月 30 日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108703/documents/sehk26063003289_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108703/documents/sehk26063003290.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视为对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需满足多项条件，包括但不限于取得中国证券监督管理委员会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年7月1日